



Procesor Intel® Core™ m5-6Y57

pamięć cache 4 MB, nawet do 2,80 GHz

Niezbędne zasoby

- Kolekcja produktów [Procesory Intel® Core™ m szóstej generacji](#)
- Nazwa kodowa [Nazwa Skylake poprzednich produktów](#)
- Segment rynku pionowego Mobile
- Numer procesora M5-6Y57
- Stan Launched
- Data rozpoczęcia Q3'15
- Litografia 14 nm
- Rekomendowana cena klienta \$281.00

Wydajność

- Liczba rdzeni 2
- Liczba wątków 4
- Bazowa częstotliwość procesora 1,10 GHz
- Maks. częstotliwość turbo 2,80 GHz
- Cache 4 MB SmartCache
- Szybkość magistrali 4 GT/s OPI
- TDP 4,5 W
- Konfigurowalny tryb TDP-up 7 W
- Konfigurowalny tryb TDP-down 3,5 W

Informacje uzupełniające

- Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych Nie
- Dane katalogowe [Wyświetl teraz](#)
- Opis produktu [Wyświetl teraz](#)

Dane techniczne pamięci

- Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci) 16 GB
- Rodzaje pamięci LPDDR3-1866, DDR3L-1600
- Maks. liczba kanałów pamięci 2
- Maks. przepustowość pamięci 29,8 GB/s
- Obsługa pamięci ECC † Nie

Grafika wbudowana w procesor

- Układ graficzny procesora † Intel® HD Graphics 515
- Częstotliwość podstawowa układu graficznego 300 MHz
- Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego 900 MHz

- Maks. pamięć wideo układu graficznego 16 GB
- Wyjście do grafiki eDP/DP/HDMI/DVI
- Obsługa 4K Yes, at 60Hz
- Maks. rozdzielczość (HDMI 1.4)‡ 4096@2304@24Hz
- Maks. rozdzielczość (DP)‡ 3840x2160@60Hz
- Maks. rozdzielczość (eDP – wbudowany płaski wyświetlacz)‡ 3840x2160@60Hz
- Maks. rozdzielczość (VGA)‡ N/A
- Obsługa DirectX* 12
- Obsługa OpenGL* 4.5
- Intel® Quick Sync Video Tak
- Technologia Intel® InTru™ 3D Tak
- Technologia Intel® Clear Video HD Tak
- Technologia Intel® Clear Video Tak
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy † 3
- Identyfikator urządzenia 0x191E

Opcje rozszerzeń

- Wersja PCI Express 3.0
- Liczba konfiguracji PCI Express † 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1
- Maksymalna liczba linii PCI Express 10

Specyfikacja obudowy

- Obsługiwane gniazda FCBGA1515
- Maks. konfiguracja procesora 1
- T_{JUNCTION} 100°C
- Wymiary obudowy 20mm X 16.5mm

Technologie zaawansowane

- Technologia Intel® Turbo Boost † 2.0
- Intel® vPro™ — kryteria kwalifikowalności platformy † Tak
- Technologia Intel® Hyper-Threading † Tak
- Technologia Intel® Virtualization (VT-x) † Tak
- Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) † Tak
- Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) † Tak
- Intel® TSX-NI Tak
- Intel® 64 † Tak
- Zestaw instrukcji 64-bit
- Rozszerzony zestaw instrukcji Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
- Stany bezczynności Tak
- Udoskonalona technologia Intel SpeedStep® Tak
- Technologie monitorowania chłodzenia Tak
- Intel® Flex Memory Access Tak
- Program stabilnych platform firmy Intel® ułatwiających pracę administratorom Tak
- Technologia Intel® Smart Response Tak
- Technologia Intel® My WiFi Tak

Niezawodność i bezpieczeństwo

- Intel® AES New Instructions Tak
- Secure Key Tak

- Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) Tak
- Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) Tak
- Technologia Intel® Trusted Execution † Tak
- Funkcje Execute Disable Bit † Tak
- Intel® OS Guard Tak